



ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CORPORATION LIMITED

上海先進半導體製造股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股份代號：3355)

2007 年中期初步業績公告
截至 2007 年 6 月 30 日止六個月

中期業績

上海先進半導體製造股份有限公司(「本公司」)董事會成員(「董事會」)將截至2007年6月30日六個月的中期報告公佈如下：

損益表

截至2007年6月30日止六個月

		截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數)	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數)	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數)	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數)
	附註	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營業額	4	271,189	579,452	334,983	653,825
銷售成本		(291,052)	(603,106)	(276,627)	(547,301)
毛利		(19,863)	(23,654)	58,356	106,524
銷售及市場推廣開支		(2,278)	(4,250)	(1,968)	(4,161)
行政開支		(20,069)	(36,245)	(19,121)	(36,953)
研發成本		(9,016)	(20,294)	(12,005)	(20,016)

		截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
附註					
經營業務(虧損)/溢利		(51,226)	(84,443)	25,262	45,394
其他收入	4	8,404	15,936	3,084	11,014
融資成本	5	(10,593)	(24,161)	(17,425)	(32,398)
除所得稅前之 (虧損)/溢利	5	(53,415)	(92,668)	10,921	24,010
所得稅退款/(開支)	6	17,969	19,713	(897)	(1,879)
淨(虧損)/溢利		<u>(35,446)</u>	<u>(72,955)</u>	<u>10,024</u>	<u>22,131</u>
股息	7	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
本公司普通股股東 每股(虧損)/盈利 — 基本	8	<u>(2.31)分</u>	<u>(4.76)分</u>	<u>0.67分</u>	<u>1.69分</u>

資產負債表
2007年6月30日

		2007年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2006年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		1,748,212	1,941,434
在建工程		1,709	1,929
土地租賃預付款		35,470	35,854
無形資產		16,452	17,559
遞延稅項資產		27,508	7,795
非流動資產總值		<u>1,829,351</u>	<u>2,004,571</u>
流動資產			
存貨		235,706	261,829
應收貿易賬款及應收票據	9	147,844	137,802
預付款項、按金及其他應收款項		20,023	21,736
應收關聯公司款項		20,922	35,894
現金及現金等價物		62,537	396,987
流動資產總值		<u>487,032</u>	<u>854,248</u>
資產總值		<u>2,316,383</u>	<u>2,858,819</u>
流動負債			
應付貿易賬款	10	124,569	194,344
應計負債及其他應付款項		69,984	95,433
應付關聯公司款項		9,674	12,492
計息借款		281,265	286,451
流動負債總值		<u>485,492</u>	<u>588,720</u>
流動資產淨值		<u>1,540</u>	<u>265,528</u>
非流動負債			
計息長期借款		89,123	455,376
資產淨值		<u>1,741,768</u>	<u>1,814,723</u>
股本及儲備			
註冊及繳足股本		1,534,227	1,534,227
儲備		207,541	280,496
股東權益		<u>1,741,768</u>	<u>1,814,723</u>

權益變動表

截至2007年6月30日止六個月

	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
註冊及繳足股本		
普通股每股面值人民幣1.00元		
期初餘額	1,534,227	1,109,080
全球招股	—	425,147
期末餘額	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>
資本儲備		
期初餘額	205,363	39
全球招股	—	205,324
期末餘額	<u>205,363</u>	<u>205,363</u>
法定盈餘公積		
期初餘額和期末餘額	<u>19,353</u>	<u>12,902</u>
法定公益金		
期初餘額和期末餘額	<u>—</u>	<u>6,451</u>
未分配利潤		
期初餘額	55,780	51,837
本期溢利	—	22,131
本期虧損(未審數)	(72,955)	—
期末餘額	<u>(17,175)</u>	<u>73,968</u>
儲備	<u>207,541</u>	<u>298,684</u>
股東權益	<u>1,741,768</u>	<u>1,832,911</u>

現金流量表

截至2007年6月30日止六個月

	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
經營業務現金流量		
除所得稅前(虧損)／溢利	(92,668)	24,010
調整項目：		
折舊	194,023	184,688
無形資產攤銷	1,916	1,718
土地使用權攤銷	384	385
處置物業、廠房及設備之虧損	698	1,545
在建工程減值準備沖回	—	(1,299)
存貨跌價準備	12,725	9,389
利率掉期之公允價值損失／(收益)	281	(2,083)
利息開支	24,161	32,398
利息收入	(9,150)	(2,824)
營運資金變動前之經營溢利	132,370	247,927
應收貿易賬款及應收票據增加	(10,042)	(11,627)
存貨減少／(增加)	13,398	(62,072)
預付款項、按金及其他應收款項(增加)／減少	(6,535)	5,644
關聯公司款項減少／(增加)	12,154	(24,951)
應付貿易賬款(減少)／增加	(69,775)	63,252
應計負債及其他應付款項(減少)／增加	(25,449)	10,250
經營業務現金流量	46,121	228,423
已付利息	(24,161)	(32,398)
已收利息	16,521	2,824
經營業務現金流入淨額	38,481	198,849

	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
投資活動現金流量		
購買物業、廠房及設備、在建工程及無形資產	(3,343)	(189,786)
建造合資格資產應佔之資本化利息	—	(231)
	<hr/>	<hr/>
物業、廠房及設備及在建工程之增加總額	(3,343)	(190,017)
處置物業、廠房及設備	1,851	—
	<hr/>	<hr/>
投資活動之現金流出淨額	(1,492)	(190,017)
	<hr/>	<hr/>
融資活動現金流量		
發行股份所得款項	—	775,776
股份發行開支	—	(70,967)
新增銀行貸款	116,390	159,912
償還銀行貸款	(487,829)	(578,653)
	<hr/>	<hr/>
融資活動現金(流出)／流入淨額	(371,439)	286,068
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物(減少)／增加淨額	(334,450)	294,900
現金及現金等價物之期初餘額	396,987	105,886
	<hr/>	<hr/>
現金及現金等價物之期末餘額	62,537	400,786
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
現金及現金等價物結餘分析		
現金及銀行存款	62,537	74,265
未抵押定期存款	—	326,521
	<hr/>	<hr/>
	62,537	400,786
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

簡明財務報表附註

2007年6月30日

1. 公司資料

上海先進半導體製造股份有限公司(以下簡稱「本公司」)為按照中國《外商投資企業法》於1988年10月4日在中國人民共和國成立之外商投資企業，經營期限30年，從1988年10月4日至2019年10月3日。

於2004年3月2日，本公司通過發行1,109,080,000股每股價值為人民幣1.00元繳足之股本重新註冊為外商投資股份有限公司，經營期限為不定期。於2006年4月7日，本公司的H股在香港聯交所成功上市。

本公司的註冊所在地及主要經營地位於中國上海虹漕路385號(郵編200233)。

本公司主要從事5寸、6寸和8寸晶圓的生產製造和銷售。

2. 呈報基準

本未審中期簡明財務報表乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則附錄十六之適用披露要求以及國際會計準則理事會頒佈之國際會計準則第34號《中期財務報告》編製。

本未審中期簡明財務報表並非包括所有年度報告中所要求的信息和披露，因此須與截至2006年12月31日止年度的財務報告一併進行閱讀。

除以下所述，本公司在編製本未審中期簡明財務報表所採納的會計政策以及計算方法與本公司於截至2006年12月31日止的年度財務報表所採納者一致，除在其重大會計政策中披露外，該等未審中期簡明財務報表是按照國際財務報告準則之歷史成本法編製。

於2007年，本公司採納了以下與公司業務相關的最新修訂、頒佈並對自2007年1月1日或以後日期開始的會計期間生效的國際財務報告準則：

國際會計準則第1號修訂版

資本披露

國際財務報告準則第7號

金融工具：披露

國際財務報告準則解釋委員會解釋第10號

中期財務報告和減值

以上準則和解釋的採納並未對本公司的財務狀況及經營成果產生重大影響。

新發佈但還未生效之國際財務報告準則的影響

本公司還未採納下述新發佈及修訂之國際財務報告準則，其已發佈但還未生效。以下國際財務報告準則將對自2008年1月1日或以後日期開始之會計年度生效：

國際財務報告準則第8號

經營分部

國際會計準則第23號修訂版

借款成本

國際財務報告準則第8號將會影響公司對經營性分部、主要產品及服務、經營之地理區域、及其主要客戶之披露。

國際會計準則第23號修訂版取消了將須經過頗長時間方可作原定用途或銷售之資產的借貸成本直接費用化的選擇權。

國際財務報告準則第8號將取代國際財務報告準則第14號，並自2009年1月1日或以後日期開始之會計年度生效。國際會計準則第23號修改版適用於2009年1月1日或之後開始之會計期間。

除上述外，本公司預期採用上述準則將不會對本公司的財務狀況及經營成果產生重大影響。

3. 分類資料

本公司之營業額及溢利主要來自晶圓銷售。本公司僅有一個業務類別。

本公司主要資產位於中國上海，因此，並未對本公司資產地理位置提供分類資料。

本公司營業額乃按客戶所在地進行地理分區。基於客戶所在地之營業額地區分類資料列示如下：

	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
美國	169,063	307,195	178,351	373,985
歐洲	64,463	135,459	77,327	155,227
亞洲	37,663	136,798	79,305	124,613
	<u>271,189</u>	<u>579,452</u>	<u>334,983</u>	<u>653,825</u>

4. 營業額及其他收入

	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
營業額				
貨物銷售	270,880	579,129	334,843	653,655
其他	309	323	140	170
	<u>271,189</u>	<u>579,452</u>	<u>334,983</u>	<u>653,825</u>
其他收入				
利息收入(按歷史成本法)	3,726	9,150	2,600	2,824
補貼收入	12	12	—	—
技術服務收入	—	220	—	266
保險賠償	742	742	—	—
其他服務收入	298	298	—	—
淨匯兌收益／(損失)及其他 利率互換上的公允價值 收益／(虧損)	3,381	5,795	(1,599)	5,841
	245	(281)	2,083	2,083
	<u>8,404</u>	<u>15,936</u>	<u>3,084</u>	<u>11,014</u>
	<u>279,593</u>	<u>595,388</u>	<u>338,067</u>	<u>664,839</u>

5. 除所得稅前之(虧損)/溢利

除所得稅前之(虧損)/溢利已扣除下列各項：

	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
銀行貸款利息	10,593	24,161	17,425	32,629
減：資本化利息	—	—	—	(231)
融資成本(按歷史成本法)	10,593	24,161	17,425	32,398
資本化利息之平均利率	—	—	—	4.93%
折舊	95,788	194,023	95,340	184,688
存貨跌價準備	8,114	12,725	664	(13)

6. 稅項

由於本公司截至2006年、2007年6月30日止各六個月並無在香港獲得任何應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出準備。

根據國家稅務法規，本公司位於中國上海市漕河涇經濟技術開發區的高新技術企業，適用的企業所得稅稅率為15%。根據中國目前稅法，本公司於第一及第二個獲利年度(經抵銷累積稅項虧損，該累積稅項虧損可結轉應用期限最多五年)可獲豁免全部企業所得稅，且隨後三年可獲減免50%。

作為有能力生產線寬相等於或低於0.25微米之芯片晶圓製造商，並根據相關稅務機構於2004年6月17日發出之批文，本公司於2004年至2008年五年期間有權再享受50%所得稅減免。因此，本公司於截至2006年及2007年6月30日止各六個月按7.5%之適用所得稅稅率繳納中國所得稅。

截至2006年及2007年6月30日止六個月，所得稅(退款)／開支淨額主要構成如下：

	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數) 人民幣千元	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數) 人民幣千元
本期就溢利所作出 之所得稅準備 — 當期	—	—	—	—
遞延稅項	<u>(17,969)</u>	<u>(19,713)</u>	<u>897</u>	<u>1,879</u>
所得稅(退款)／開支	<u><u>(17,969)</u></u>	<u><u>(19,713)</u></u>	<u><u>897</u></u>	<u><u>1,879</u></u>

二零零七年三月十六日舉行的第十屆全國人民代表大會第五次會議上，中華人民共和國所得稅法(「新企業所得稅法」)已獲批准及將於二零零八年一月一日生效。新企業所得稅法作出了大範圍變動，包括但不限於將國內投資及國外投資的企業的所得稅率統一為25%。國家需要重點扶持的高新技術企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。

到目前為止，該未經審核中期簡明財務報表已被批准公告，新企業所得稅法具體的實施細則、所得稅具體計算方法和稅法的優惠政策等尚未公佈，當具體的實施細則予以公佈時，本公司會估計稅率變動對於本公司的影響。

根據國際會計準則第12號的規定，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債應當按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。於2007年6月30日，本公司按照預期收回遞延所得稅資產期間的適用稅率評估及計量遞延所得稅資產，基於此，由於稅率的變動使得本期所得稅退款增加人民幣6,569,000元。

7. 股息

董事建議不派發截至2007年6月30日止三個月及六個月股息(截至2006年6月30日止六個月：無)。

8. 普通股股東每股(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利乃按本公司普通股股東應佔淨(虧損)/盈利除以於相應期間內加權平均發行在外之股數計算。

	截至2007年 6月30日止 三個月 (未審數)	截至2007年 6月30日止 六個月 (未審數)	截至2006年 6月30日止 三個月 (未審數)	截至2006年 6月30日止 六個月 (已審數)
普通股股東(虧損)/盈利 (人民幣'000)	<u>(35,446)</u>	<u>(72,955)</u>	<u>10,024</u>	<u>22,131</u>
加權平均普通股股本('000)	<u>1,534,227</u>	<u>1,534,227</u>	<u>1,503,758</u>	<u>1,307,509</u>

因無導致每股(虧損)/盈利攤薄之事項存在，故於截至2007年及2006年6月30日止六個月經攤薄之每股(虧損)/盈利作披露。

9. 應收貿易賬款及應收票據

	2007年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2006年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
應收賬款	147,844	137,802
應收票據	—	—
	<u>147,844</u>	<u>137,802</u>

本公司提供給客戶的信用期限一般為30天到60天。

本公司應收貿易賬款及應收票據的賬面金額約相當於公允價值。

	2007年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2006年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
按賬齡分類之餘額：		
30天內	82,966	79,462
31天至90天	49,900	57,567
91天至180天	14,978	557
181天至365天	—	216
	<u>147,844</u>	<u>137,802</u>
減：呆壞賬準備	—	—
	<u>147,844</u>	<u>137,802</u>

2007年6月30日到期但未減值的應收貿易賬款帳齡分析如下：

	合計 人民幣千元	既未到期 又未減值 人民幣千元	已到期但未減值		
			<60天 人民幣千元	60—180天 人民幣千元	180—360天 人民幣千元
2007年6月30日	147,844	96,732	36,436	14,676	—
2006年12月31日	137,802	84,103	52,935	461	303

10. 應付貿易賬款

	2007年 6月30日 (未審數) 人民幣千元	2006年 12月31日 (已審數) 人民幣千元
按賬齡分類之餘額：		
30天內	83,320	144,646
31天至90天	30,387	33,790
91天至180天	3,339	7,245
181天至365天	5,239	3,461
超過365天	2,284	5,202
	<u>124,569</u>	<u>194,344</u>

本公司應付貿易賬款的賬面金額約相當於公允價值。

管理層討論及分析

截至二零零七年六月三十日止六個月與截至二零零六年六月三十日止六個月的比較

銷售額

因受行業週期性影響，截至二零零七年六月三十日止六個月的本公司銷售額為人民幣5.795億元，較截至二零零六年六月三十日止六個月的銷售額人民幣6.538億元下降11.4%。在報告期內，本公司8英寸等值晶圓的交付量由二零零六年六月三十日止六個月的223,982片略減至二零零七年六月三十日止六個月的221,514片。

銷售成本及毛利

截至二零零七年六月三十日止六個月的本公司毛利為人民幣負2,370萬元，毛利率為負4.1%，截至二零零六年六月三十日止六個月的毛利為人民幣1.065億元，毛利率為16.3%，毛利率下降主要源於受半導體行業庫存調整形成欠理想的5英寸和6英寸晶圓產品組合及8英寸晶圓供應增加。

經營費用及經營收益

截至二零零七年六月三十日止六個月銷售及市場推廣開支為人民幣430萬元，與截至二零零六年六月三十日止六個月的銷售及市場推廣開支人民幣420萬元基本持平。

截至二零零七年六月三十日止六個月行政開支為人民幣3,620萬元，與截至二零零六年六月三十日止六個月的行政開支人民幣3,700萬比較，略減2.2%。

截至二零零七年六月三十日止六個月研發成本為人民幣2,030萬元，與截至二零零六年六月三十日止六個月的研發成本人民幣2,000萬元基本持平。

因此，本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的經營業務虧損為人民幣8,440萬元，截至二零零六年六月三十日止六個月的經營業務利潤則為人民幣4,540萬元。本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的經營毛利率為負14.6%，截至二零零六年六月三十日止六個月的經營毛利率為6.9%。

其他收入及融資成本

本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的其他收入為人民幣1,590萬元，較去年同期的人民幣1,100萬元上升45.0%，主要是源於利息收入增加，並部分被同期利率掉期之公允價值損失所抵消。

本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的融資成本為人民幣2,420萬元，較截至二零零六年六月三十日止六個月的融資成本人民幣3,240萬元下降25.3%，主要為本公司銀行貸款餘額降低導致利息支出減少。

淨利潤

綜上所述，本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的淨虧損為人民幣7,300萬元，截至二零零六年六月三十日止六個月的淨利潤為人民幣2,210萬元。

流動資金及資金來源

於二零零七年六月三十日及二零零六年十二月三十一日，本公司的現金及現金等價物分別為人民幣6,250萬元和人民幣3.97億元。截至二零零七年六月三十日，本公司的經營業務之現金流入淨額為人民幣3,850萬元，截至二零零六年六月三十日止的經營業務之現金流入淨額人民幣1.988億元。

本公司的投資活動現金流出淨額主要用於對物業、廠房、設備以及在建工程的持續投資。截至二零零七年六月三十日，本公司的投資活動現金流出淨額為人民幣330萬元。去年同期的投資活動現金流出淨額為人民幣1.9億元。

截至二零零七年六月三十日和二零零六年六月三十日，本公司的融資活動現金流出和流入的淨額分別為人民幣3.714億元和人民幣2.861億元。前者主要是在報告期內由於償還銀行貸款人民幣4.878億元和新增銀行貸款人民幣1.164億元。在報告期內，本公司主要依託銀行貸款來從事經營活動。在2006年上半年，公司除了依託銀行貸款，還利用其首次股票公開發行所募集的資金來從事經營活動。

於二零零七年六月三十日，本公司短期付息借款餘額為人民幣2.813億元，長期借款餘額為人民幣8,910萬元，其中1億美元銀團長期貸款協議中未償還貸款為人民幣2.993億，根據本公司於2007年6月與各借款行所簽署的補充協議書（「協議書」），該項貸款將予以分期支付，並將於二零零八年九月三十日前給予全部還清。本公司二零零五年三月三十一日之1億美元長期借款中未償還貸款由本公司物業、廠房及設備、在建工程和土地使用權作抵押。

因受半導體行業週期性影響，1億美元銀團長期貸款中現有部分財務指標存在欠合適性。根據協議書一部分，包括總負債淨額與未計利息、稅項、折舊及攤銷前之盈利之比和償債保證比兩項財務指標予以取消，而總負債淨額與有形淨資產之比的財務指標仍繼續適用，直至二零零八年九月三十日。此外，本公司在2007年及2008年資本開支分別限定為560萬美元和1,000萬美元。在報告期間，本公司達到了1億美元銀團貸款中規定的相關財務指標。

截至二零零七年六月三十日止，本公司的流動比率為1.00，截至二零零六年十二月三十一日止為1.45。本公司的總負債與股東權益之比由二零零六年十二月三十一日19.0%改善至二零零七年六月三十日之17.7%。

員工

截至二零零七年六月三十日止，本公司聘用1,810名員工，與截至二零零六年十二月三十一日止的1,856員工相比，員工數下降2.5%。本公司在報告期內與其員工維持著良好工作關係並按照中國相關法規和政策為員工提供和支付報酬和福利。

利率風險

本公司付息貸款和借款受倫敦銀行同業拆息及利差影響。鑒於本公司債務中大部分是美元債,公司盈利能力受制於倫敦銀行同業拆借美元利息波動所引發的利率風險。本公司在1億美元長期貸款尚未還款3,930萬美元之中,其中對提款額中2,130萬美元應付利息訂立利率掉期,以對沖利率波動風險。

人民幣波動風險

由於人民幣是中國(本公司經營所在地的主要經濟環境)的法定貨幣,本公司的財務和申報貨幣為人民幣。如果本公司的人民幣收入不足以支付人民幣支出,則需要將外幣轉換為人民幣來彌補差額,在轉換中可能引起匯兌虧損,直至導致對本公司現金流量產生負面影響。在報告期內,本公司沒有運用金融衍生工具規避人民幣升值。

資本承諾

截至二零零七年六月三十日止,本公司購買物業、廠房、設備的資本承諾為人民幣4,950萬元,其中人民幣1,960萬元為已訂約但未撥備,人民幣2,990萬元為已授權但未訂約。

二零零七年第二季度業績回顧

二零零七年第二季度銷售額為人民幣2.712億元,相比二零零七年第一季度銷售額人民幣3.083億元,下降12.0%,主要源於公司主要客戶之一的高位庫存定位調整所致。

二零零七年第二季度毛利為人民幣負1,990萬元,毛利率為負7.3%。二零零七年第一季度毛利為人民幣負380萬元,毛利率為負1.2%,主要源於較低產能利用率。

二零零七年第二季度營業開支為人民幣3,140萬元，較二零零七年第一季度營業開支人民幣2,940萬元上升6.8%，主要歸因於銷售及市場推廣開支和行政開支增加，且部分為研發費用下降所抵消。

二零零七年第二季度其他收入和融資成本為人民幣負220萬元，二零零七年第一季度其他收入和融資成本為人民幣負600萬元，主要源於較高其他收入和較低融資成本。第二季度其他收入較第一季度上升12%至人民幣840萬元，主要源於人民幣升值所致的匯兌收益，及由倫敦銀行同業拆息和人民幣升值引起利率掉期收益增加，且部分為利息收入減低所抵消。第二季度融資成本較第一季度下降主要由於第一季度支付了1億美元長期貸款中的1,970萬美元致使第二季度利息支出減少所致。

因此，二零零七年第二季度淨虧損為人民幣3,540萬元，二零零七年第一季度淨虧損為人民幣3,750萬元。

1. 營業額分析

用途	第二季度07	第一季度07	第二季度06
通訊	33%	32%	32%
電腦	33%	33%	34%
消費品	34%	35%	34%

二零零七年第二季度本公司在通訊，電腦，消費品方面的營業額分別佔總收入的33%，33%和34%，與第一季度基本持平。

地區	第二季度07	第一季度07	第二季度06
美國	62%	45%	53%
歐洲	24%	23%	23%
亞太地區	14%	32%	24%

二零零七年第二季度本公司在北美的銷售佔總收入的62%，上季度為45%。同樣，亞太地區的銷售佔總收入的14%，較上季度的32%有所降低，主要原因為本公司亞太地區一主要客戶高位庫存定位調整所致。

客戶類型	第二季度07	第一季度07	第二季度06
集成器件製造商	34%	31%	42%
無生產線半導體公司	66%	69%	58%

二零零七年第二季度集成器件製造商和無生產線半導體公司的銷售佔總收入分別為34%和66%。

2. 利用率和產能 (8”等值晶圓)

	第二季度07	第一季度07	第二季度06
利用率	62%	68%	69%
產能 (千片)	154	154	154

附註：

- 1) 產能利用率指報告期內用於已裝運的半導體晶圓的加工程序的實際數 (以Mask層數計算) 除以晶圓製造廠可於相應期間內提供的加工程序總數的百分比。
- 2) 5寸、6寸和8英寸的產能分別以每片晶圓9、10和22 Mask層數估算。5、6寸晶圓需將晶圓片數分別除以2.56和1.78，以換算為8英寸等值晶圓 (22個Mask層數)

二零零七年第二季度整體的產能利用率較上季度降低6個百分點至 62%。

二零零七年第二季度產能為154,000片8英寸等值晶圓，與二零零七年第一季度及二零零六年第二季度持平。

3. 應收賬款／存貨周轉率

	第二季度07	第一季度07	第二季度06
應收賬款及票據周轉率(天數)	54	46	46
存貨周轉率(天數)	73	73	69

二零零七年第二季度應收賬款及票據周轉天數為54天，較上季度46天上升，主要源於第二季度較低銷售收入。

二零零七年第二季度存貨周轉天數為73天，與上季度持平。

4. 資本支出

	第二季度07	第一季度07	第二季度06
	(金額：人民幣千元)		
資本支出	1,445	1,898	32,951

二零零七年第二季度資本支出為人民幣140萬元，第一季度為人民幣190萬元。

股份轉讓

根據中華人民共和國商務部於二零零七年七月十九日發出之批文，Royal Philips 透過 Philips Electronics China B.V.原持有本公司共計408,806,888 之H股或佔本公司已發行總股本26.65%的股份獲批准轉由NXP B.V.持有。

前景及未來計劃

本公司董事會對財政年度上半年業績非常失望。繼聘請呂學正先生作為本公司總裁及首席執行長之後，本公司組建了一支新的管理領導層。

在未來三個月，本公司管理層將對其現有所有業務進行評審。該評審將著重在本公司客戶關係，技術能力及規劃包括現金流量預測和資產估值。

半導體行業預期在不久將來至多呈現適度增長。此外，一些區域性的晶圓代工廠已表示意在未來轉向模擬半導體生產。這些因素會令本公司將面臨持續市場挑戰日益加劇競爭。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至二零零七年六月三十日止六個月，本公司概無購買、出售或贖回任何本公司的上市證券。

遵守企業管治常規守則（「管治守則」）

本公司承諾維持高水平的企業管治，以便確保提高透明度以及對股東利益的保護。截至二零零七年六月三十日的六個月期間內，本公司完全遵守上市規則附錄14載列的管治守則。

經審計委員會審閱

本公司審計委員會包括三位獨立非執行董事，James Arthur Watkins先生（主席）、Thaddeus Thomas Beczak先生和沈偉家先生，以及兩位非執行董事，Petrus Antonius Maria Van Bommel先生和諸培毅先生。本公司截至二零零七年六月三十日止六個月的中期報告未經審計，但已經由審計委員會及公司的外部審計安永會計師事務所審閱。

承董事會命
上海先進半導體製造股份有限公司
執行董事及副總裁
程堅玉

中國上海，二零零七年八月十六日

於本公佈日期，本公司以程堅玉為執行董事；以阮延華、Ajit Manocha、諸培毅、朱健、肖永吉及Petrus Antonius Maria van Bommel為非執行董事；及以Thaddeus Thomas Beczak、沈偉家及James Arthur Watkins為獨立非執行董事。